

IPC中国电子制造年会

Time: Mar.18-19, 2009

Venue: Shanghai New International Expo Centre

时间：2009年3月18-19日

地点：上海新国际博览中心 E3-M17会议室

Important TIME 重要时间提醒

8:30-9:00 Audience Registration 听众登记

12:00-13:30 Luncheon Time 午休时间

17:30 Close 大会结束

09:30 Conference Opening 大会开幕

13:00 Afternoon Session Begins 下午开始时间

Mar.18 2009 Wednesday		2009年03月18日 星期三	
Mar. 18 am	Topic & Speaker	3月18日 上午	主题及演讲人
09:30-09:40	Opening Remarks from Organizers David Bergman Vice President, International Relations, IPC Claudia Sixl Exhibition Group Director, Messe Muenchen International	09:30-09:40	会议主办方致辞并宣布开幕 David Bergman 国际关系副总裁 IPC Claudia Sixl 项目总监, 德国慕尼黑国际博览集团
09:40-10:00	Keynote speech: The Evolvement of telecom equipment and its requirement for Electronics Manufacturing technology Zhou Xin IPC Board Director	09:40-10:00	主题演讲 通讯电子设备的发展及其对电子制造技术的要求 周欣 华为工艺技术研部总监, IPC董事会成员
10:00-10:10	Break	10:00-10:10	休息
10:10-11:00	Screen Printing Adhesive - Capability Studies Li Yi Applied Process Engineer DEK	10:10-11:00	印胶工艺能力研究 李亿 应用工艺工程师 瑞士得可
11:00-11:50	What should the Electronics Industry do to become REACH compliant? Li Cong Direcor CIQ REACH SOLUTION CENTER	11:00-11:50	电子行业如何应对 REACH法规 李聪 国家质检总局 REACH工作组组长
11:50-12:50	Luncheon Time	11:50-12:50	午休时间
Mar. 18 pm	Topic & Speaker	3月18日 下午	主题及演讲人
13:00-13:50	Industry standards for enviromental challenges in Electronics manufacture----IPC-1752 & IPC-STD-709 Leesha Peng General Manager IPC China	13:00-13:50	关注电子制造中环保挑战的行业标准 - - IPC-1752和IPC-STD-709 彭丽霞 总经理 IPC 中国
13:50-14:40	Non-Halogen Material Solutions For Green Electronics Leon Han Segment Manager Celanese	13:50-14:40	绿色电子的无卤解决方案 韩文煜 市场经理 塞拉尼斯
14:40-14:50	Break	14:40-14:50	休息
14:50-15:40	Cover-Extend The solution to high speed/high density PCBA testing challenge Yang Hua Technical Marketing Engineer Agilent Technologies	14:50-15:40	应付高密度电路板的 ICT挑战 杨华 市场技术工程师 安捷伦科技
15:40-16:30	Emulation and design in the R&D process of Cell phone antenna Weidong Hao RF Engineer Foxconn	15:40-16:30	手机天线研发中的设计和仿真 郝卫东 RF工程师 富士康
16:30-17:20	Next Level Requirements for Ultra Fine Pitch Printing Wisdom Qu Senior Technical Support Engineer Indium	16:30-17:20	超细间距印刷进阶需求 瞿艳红 高级技术支持工程师 镭泰科技(苏州)有限公司
Mar.19 2009 Thursday		2009年03月19日 星期四	
Mar.19 am	Topic & Speaker	3月19日 上午	主题及演讲人
09:30-10:20	The research of Defects Prvention on Vertical Surface-Mount Module during the Reflow Process Huang Chunguang Senior Engineer, Process Development Dept. Huawei	09:30-10:20	表贴立式模块二次回流缺陷预防模型研究 黄春光 工艺开发部 高级工程师 华为技术有限公司
10:20-11:10	Reinforced Bump Interconnections Liu Jingming Application and Field Service Engineer Asymtek	10:20-11:10	焊球连接的加固工艺 刘静鸣 应用服务工程师 Asymtek
11:10-11:20	Break	11:10-11:20	休息
11:20-12:10	Non-Galvanic-Corrosion Copper Microetchants Zheng Bo Senior Research & Development Chemist Cookson Electronics - Enthone	11:20-12:10	无原电池腐蚀现象的系列铜微蚀剂 郑博 高级研究与开发化学师 确信电子-乐思化学
Mar.19 pm	IPC TGAsia Session	3月19日 下午	IPC TGAsia 专题会议
	Topic & Speaker		主题及演讲人
13:20-14:10	The Study of QFN Components Assembly Process Jack Zhao Manager, Basic Technical Process Dept. Emerson Network Power Co., Ltd.	13:20-14:10	QFN元器件的工艺应用研究 赵景清 经理 基础工艺室 艾默生网络能源有限公司
14:10-15:00	Discussion on Soldering Process of Dual-array QFNs in System Products Tang Xuemei Process Manager ZTE Corporation	14:10-15:00	系统产品中双排QFN的焊接工艺探讨 唐雪梅 经理 物流体系生产工艺部 中兴通讯股份有限公司
15:00-15:15	Break	15:00-15:15	休息
15:20-16:10	A Further Study and Improvement Research on Some IPC Test Methods TBA The fifth Electronics Research Institute of Ministry of Information Industry (CEPREI Laboratory)	15:20-16:10	部分IPC标准测试方法的再研究与改进探讨 演讲人待定 信息产业部电子第五研究所 (中国赛宝实验室)
16:10-17:00	reserved	16:10-17:00	预留

Note: The organizer preserves the right to change the agenda; the final agenda should be based on the actual one declared on the opening day of the event.

注：主办机构保留变更日程的权力；最终的日程以活动当天发布的为准。